

RESISFY

<概要>

RESISFY是一种耐热・透明树脂，由Denka独自的精密聚合技术所开发的「苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-无水马来酸酐聚合物（SMM）树脂」。

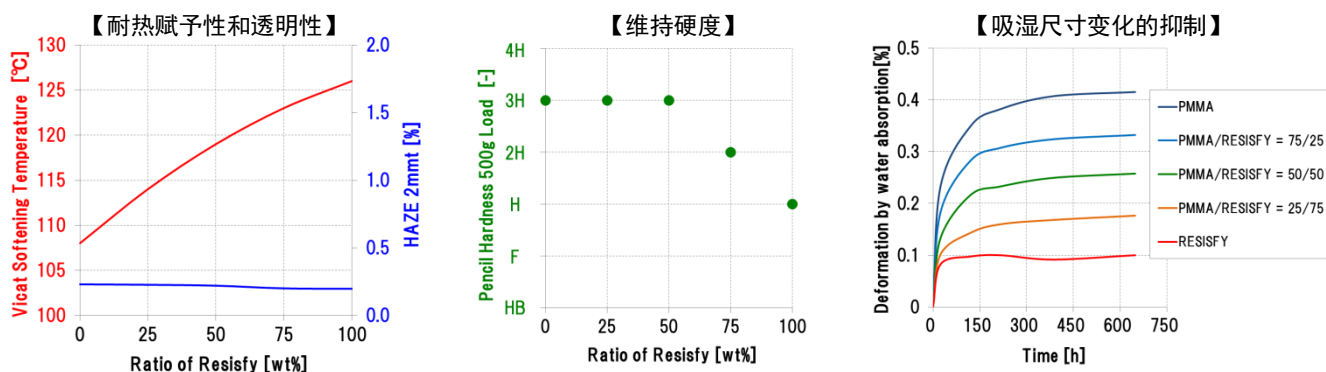
RESISFY适用于对耐热性和透明性有要求的部件。

同时也可以作为赋予亚克力树脂耐热性或低吸湿性等机能的添加剂。

<特征>

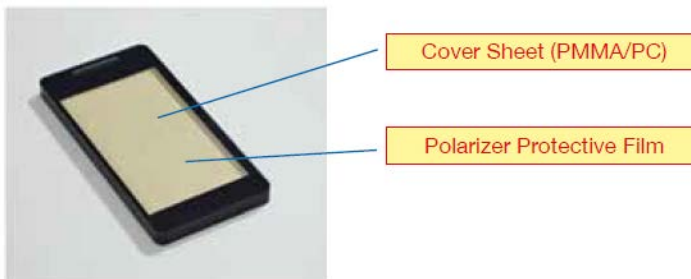
・高耐热性 ・高透明性 ・高硬度 ・低吸湿性 ・低比重 ・和PMMA树脂的相溶性

<混合亚克力树脂后的性能>



<用途例>

- ・PMMA树脂的耐热添加剂
- ・触摸屏的前面板
- ・液晶显示器用光学膜
(相位差膜、偏光片保护膜等)
- ・LED光源镜片
- ・高漆黑复合树脂 (钢琴黑材料)



物性项目	规格	测定条件	单位	牌号		PMMA混合特性例	
				R-100	R-200	PMMA	R-200/PMMA =50/50
				標準	耐熱		
MFR	ISO 1133	230°C, 37.3N	g/10min	4.2	1.8	1.6	1.8
维卡软化温度	ISO 306	50N	°C	126	132	108	121
密度	ISO 1183	23°C	kg/m ³	1.14	1.16	1.19	1.18
全光线透过率	ISO 13468	2mmt	%	91	91	93	91
雾度	ISO 14782	2mmt	%	0.2	0.2	0.2	0.3
折射率	ISO 489	D line	-	1.56	1.55	1.49	1.52
铅笔硬度		500g荷重	-	H	H	3H	3H

※表中的数值为测定值，非保证值。